鋳造

鋳ぐるみ材」に活用 外販年間1億円目指す半導体関連向け拡販、

ろなどにあらかじめ埋|3月完工、4月操業開 主に社内で鋳造する際 新設すると発表した。 リンターを川崎工場 内最大級の金属3Dプ 日、3億円を投じて国|材)として活用し、鋳 に欠陥が出やすいとこ (神奈川県川崎市) に 日本鋳造は10月31|め込む部材(鋳ぐるみ |1億円を目指す。来年 までに外販売上高年間 の外販も行い、28年度 |なげる。半導体製造装 |造製造の品質向上につ 置向け部材などとして 一始する。 しながら積層造形する |粉末をレーザーで焼結 ロプリンター一BLT ―S450」で、金属 (BLT社) 製金属3

|ン・ブライト・レーザ|さ500゚゚゚サイズで、 新設するのはセイア | 器。 縦横450 ″ 、高 品も製造できる。現在 |倍以上大きい体積の製 一ている既存機よりも5 パウダーベッド式の機

ー・テクノロジーズ|現在同社が2台所有し|とする。

S450 I Manufacturing

る。 部材も製造可能とな | などを武器に航空宇宙 シリコンウエハー対応 の半導体製造装置向け 適用、複雑な造形実現 熱膨張材や高強度材の 関連、軽量化ニーズな

主流となっている125~| 代替を図るという。 低

|では既に鋳造品2品種|ぐるみ材の適用製品を

(年間40~80台出荷)

|31品まで増やす。

も4分の1短くできる か、納期は既存機より スト削減につながるほ 7本多い8本となるた | として使えば、鋳造欠 め造形速度が向上。コ 本数も既存機のよりも 加えて、レーザーの 陥を減らせる。既存機 どの需要捕捉も図る。

|新機導入により今後鋳|努めるとする。

用後は0%となった。 程度あったものが、適

らなる鋳造品質向上に

|み材の開発も進め、

の苦情が適用前に15% |検討している。 鋳ぐる

欠陥に関する顧客から 適用しているが、鋳造 について鋳ぐるみ材を

|があり、同社も導入を |の金属3Dプリンター 市場にはさらに大型

鋳造時の鋳ぐるみ材

幸部長は「航空宇宙関 |連も含めて既に4社ほ 企画管理部の大山伸 ど引き合いが

リンターはエ 既に手応えを 示す。3Dプ 納期や価格面 程数が少なく に優位性があ



